

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-0615

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 调研：线下 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
来访人	中泰证券、长江证券、东北证券、国联民生、上海尘星资产、中信保诚基金、安徽银桥投资
来访人类型	投资者 <input checked="" type="checkbox"/> 证券机构 <input checked="" type="checkbox"/> 新闻媒体 <input type="checkbox"/> 其他：_____
上市公司接待人员	董事会秘书：夏军 公司研究院副院长：汪洋 证券事务代表：毕静
接待时间	2026年6月15日10:00时
接待地点	三佳科技党群活动服务中心三楼会议室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请介绍一下公司及主营业务情况 A1：公司成立于2000年4月，公司前身是原电子工业部所属4150、4963、4524三个军工厂，2002年1月在上交所主板上市，被誉为“中华模具第一股”。2025年1月，合肥产投集团旗下合肥市创新科技风险投资有限公司通过股权收购形式成为公司控股股东。公司经过多年发展，目前核心业务涵盖半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等；智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。半导体封装装备板块的营业收入占公司主营业务收入约70%，智能制造板块约占30%。</p> <p>Q2：公司对未来发展战略有何规划？ A2：公司以控股型上市公司为发展定位，致力于打造新兴产业投资与运营平台。遵循“立足安徽，面向全球；围绕主业，做大做强”的指导思想，坚持内生增长与外延并购双轮驱动的发展路径。以内生发展夯实业务基础，实现基本经营目标；以外延并购完善产业布局，实现超预期发展。不断强化核心竞争力，实现“国内领先、国际知名”的品牌目标。</p> <p>Q3：请介绍公司研究院的整体布局、人员配置及研发方向相关情况？ A3：公司研究院后续计划整体搬迁至合肥，重点聚焦先进封装技术迭代及公司未来新产品的研发落地，是公司核心技术创新与产品迭代的核心研发平台。在人员配置规划方面，研究院一期规划配置专职研发人员30余人，后续将根据</p>

研发项目推进及业务发展需求逐步扩充，中期规划专职研发人员规模达 50 余人。

研发业务层面，研究院主要承担公司前沿技术攻关、新品预研、工艺优化等核心工作。除研究院研发团队外，公司技术研发部还有人员 100 余人，构建了完善的技术研发、成果转化、工艺落地闭环，持续为公司产品迭代、技术壁垒构建、市场竞争力提升提供核心技术支撑。

Q4：今年订单情况如何？

A4：目前整个行业市场景气度向好，从一季度的情况来看，公司在手订单实现明显增长，基于当前良好的行业态势及公司订单储备情况，公司对顺利达成本年度订单经营目标具有信心。

Q5：行业测算塑封领域国内市场规模约 30-40 亿元，该领域业务若按热压、注塑两大工艺拆分，公司整体业务分部布局及占比情况如何？

A5：结合当前塑封行业市场结构、公司现有技术储备、产线布局及业务规划，针对国内塑封市场，公司热压工艺与注塑工艺相关业务布局、产能及市场拓展规划约各占 50%左右。

Q6：请问公司目前核心客户合作情况如何，在行业内的配套供应地位具备哪些优势？

A6：目前公司已成为天水、长电、通富等行业头部企业的最佳供应商，与上述核心客户建立了稳定、深度、常态化的战略合作关系。依托与行业头部企业的深度合作，公司进一步稳固了自身在细分领域的市场地位，持续夯实供应链核心配套优势，为后续业务稳步拓展、市场份额提升奠定了坚实基础。

Q7：公司核心产品的交货周期为多久？

A7：半导体封装系统产品交货周期平均约 90 天，模具产品交货周期平均约 45 天。通过内部提质增效，交货周期有缩短空间，公司产能可有效保障客户需求。

Q8：公司目前再融资工作进展如何？

A8：公司将于 2026 年 6 月 29 日召开股东会，会议主要审议公司再融资相关议案，后续将依规稳步推进再融资各项工作。

日期：2026年6月15日